

《关于对深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年报的问询函》
专项说明
天职业字[2018]12010-2 号

目 录

专 项 说 明	1
---------	---

关于深圳证券交易所

《关于对深圳丹邦科技股份有限公司2017年年报的问询函》

专项说明

深圳证券交易所：

关于贵所下发的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第421号）之问题中的内容，本所经过认真核查，作出如下专项说明：

一、你公司2017年度计入当期损益的政府补助金额为2,616.28万元，同比增加735.29%，请你公司补充披露上述政府补助发生的背景、原因以及相关会计处理，并说明会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师发表专业意见。

回复：

1、基本情况

公司之全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）承担了“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（以下简称02专项）国家科技重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目（项目编号：2011ZX02710），并与由北京市经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会组建的专项牵头组织单位专项实施管理办公室签订了任务合同书。任务合同书中对项目研究内容、成果、知识产权、技术指标及研发经费来源等均进行了约定。

2017年4月，专项实施管理办公室组织专家组对广东丹邦承担的02专项课题项目进行了整体验收。包括任务指标验收、财务验收两部分。验收结果表明广东丹邦完成了任务书规定的研发内容，各项技术指标、产业化销售指标、知识产权指标、人才队伍建设及平台指标等均达到任务书考核要求。同时财务验收明确了审定金额、已拨付金额及待拨付金额。并于2018年3月取得重大专项实施管理办公室出具的国家 02 专项项目证明。

2、会计师意见

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，政府补助同时满足下列条件

时，才能予以确认：（一）企业能够满足政府补助所附条件；（二）企业能够收到政府补助。同时，根据上市公司执行企业会计准则监管问题解答，中国证券监督管理委员会会计部函[2013]232号中是否可以按照应收确认政府补助的解释，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额计量。

上市公司之全资子公司广东丹邦承担的02专项课题项目研究，已经专项实施管理办公室整体验收，满足取得政府补助所附条件；同时根据任务合同约定、相关文件要求（《财政部关于下达“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项2011年预算的通知》（财教[2011]179号）、《关于02专项2011年度项目立项批复的通知》ZX02[2011]003号）、专项实施管理办公室验收证明文件、历史拨付款及对专项管理办公室的走访及函证情况综合判断，广东丹邦预计能够收到上述待拨付政府补助。

综上，我们认为，02专项待拨付政府补助部分满足《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，企业应根据具体审核情况将待拨付政府补助划分为与资产相关和与收益相关的政府补助。其中与资产相关的政府补助确认为递延收益，应在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；与收益相关的政府补助可直接计入当期损益。

二、2017年末，你公司开发支出账面余额5,902.21万元，较期初增加50.85%，请说明开发支出增长的原因，结合各个研发项目的具体进展说明本期资本化的判断依据以及会计处理的合规性。请年审会计师发表专业意见。

1、开发支出增涨的具体原因

2017年度，公司在立足于自身主营业务技术水平提升的同时在产业链的上下游展开了重点研究，主要集中在以下几个方向：

1) 主营业务相关研究

主要集中在对FCCL、FPC、COF基板及COF产品的新工艺、新技术、新产品开展研究，不断提升主营业务技术水平，保持传统核心技术竞争优势。布局了诸如“一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板技术”、“差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数的组合优化”以及“FCCL涂布法生产中涂层厚度的影响因素研究”，“激光开槽法制作FPC嵌入式微细线路技术研究”等项目。研究更先进的工艺技术，不断突破传

统工艺制作微细线路的工艺极限及封装水平，进一步提升产品关键性能指标，保持先进性，更好地适应当今电子产品小型化、薄型化、轻量化的发展趋势。

2) 功能型PI膜及其深加工产品（PI碳化膜）相关研究方向。

PI膜是公司主营业务产业链上游最重要的原材料，实现关键原材料的自产，一方面可以降低生产成本、显著提高利润率，另一方面还可以通过外销形成新的收入、利润增长点。2017年度，公司在通用型PI膜生产的基础上，继续向PI膜功能化方向展开研究，不断丰富PI膜产品的品种、扩大应用领域，满足市场多元化需求。布局了诸如“黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”、“耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”以及“微电子级超薄（12.5μ m以下）聚酰亚胺薄膜技术”等功能型PI膜研发项目，这些项目产品在光学、电子电工、航空航天等领域都有着广阔的应用前景。

依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。开展PI碳化膜方面的研究，同时为未来的产业化布局提供技术储备，是公司前瞻性研究的一个重点方向，为此布局了诸如“柔性多层（量子）碳基薄膜材料”以及“卷状连续石墨烯膜自动化生产工艺开发”等项目，对PI碳化膜的自动化生产工艺、能隙开启与调控以及复合材料等方面展开专门的研究，拓宽新材料的应用领域，抢占高端材料制高点。

2、2017年末研发项目具体进展情况

序号	项目	研发内容	项目进展
1)	微细凹印涂布法中聚酰亚胺膜厚的控制技术研究	通过单因素实验法进行科学的实验设计，得到涂布量与各因素之间的变化规律，为微细凹印涂布生产中的涂布厚度的精准控制提供参数依据	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
2)	防离子迁移的组合物及制备方法、无胶基材及制备方法	提供一种防离子迁移的组合物及其制备方法，从而提高聚酰亚胺膜的绝缘性能以及与金属层的剥离强度，满足高密度挠性电路板对其无胶基材的性能要求	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
3)	一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板	提供一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板以及柔性印刷电路板，满足柔性基板连接电子元件时对安装强度及耐热性的需求	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
4)	微电子级超薄（12.5μ m以下）聚酰亚胺薄膜技术	开发出具有自主知识产权的微电子封装级PI薄膜核心技术并实现产业化。产品性能满足高频、高	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以

序号	项目	研发内容	项目进展
		密度柔性封装基板对材料的特性要求。	及专利申报等工作
5)	柔性多层（量子）碳基薄膜材料	开发出具有自主知识产权的柔性多层石墨烯（量子）碳基半导体薄膜材料核心技术并实现产业化。产品性能满足日益小型化、高发热量电子元器件的散热需求，同时，实现石墨烯带隙的开启与调控，具备半导体性能。	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告、专利申报以及样品开发等工作
6)	柔性封装基板用碱显影感光阻焊油墨技术	改善现有技术的不足，提供一种FPC用碱显影感光阻焊油墨其硬度、显影能力、力学性能、耐化性以及耐弯曲性等能充分满足现代微细线路FPC用阻焊油墨层的要求。	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
7)	柔性封装基板用化学镀镍磷合金技术	提供一种化学镀镍磷合金的镀液，以解决现有的印制电路板镍磷合金层弯折性能差的技术问题	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
8)	差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数的组合优化	对差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数进行组合优化，制作出理想线路外形且线路厚度可控的微细线路FPC	2017年末，该项目已经结题验收，并完成技术总结报告、专利申报以及样品开发等工作
9)	基于LCP-PI薄膜的超薄芯片制作及封装技术	开发出芯片的减薄、拿持、转移、固定以及将超薄芯片集成到柔性聚合物（LCP或PI）基板上/中的技术。	2017年末，该项目已经结题验收，并完成技术总结报告、专利申报以及样品开发等工作
10)	有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究	有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究该粗化液对PI薄膜表面粗化效果好并能有效地去除薄膜表面油污及其他污渍。	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
11)	FCCL涂布法生产中涂层厚度的影响因素研究	FCCL涂布法生产中影响涂层厚度质量的因素分析及解决方案。	2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作
12)	黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺开发	提供一种黑色PI膜的制备方法。其制品表面黑色均匀度高且两面光泽度一致，光泽度低，遮光效果好。	依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段
13)	耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发	提供一种耐电晕聚酰亚胺薄膜制备方法	依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段
14)	激光开槽法制作FPC嵌入式微细线路技术研究	开发一种制作柔性电子电路的新型技术，解决现有生产工艺的局限性。	依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段
15)	原子层沉淀法（ALD）制备聚酰亚胺柔性覆铜板技术	将ALD法引入PI树脂基柔性覆铜板的制造，利用ALD法的优势，克服传统涂布法工艺中存在的弊端	依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段

3、本期资本化的判断依据以及会计处理

根据企业会计准则及相关规定，公司将开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中：
1) 研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。2) 开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目开发阶段的支出，归集于研发支出科目，符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。在项目提交专利申请并取得受理函之日起转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

内部研究开发项目开发阶段的支出资本化的条件是：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司根据企业会计准则相关规定对内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段进行了严格的划分，会计处理符合企业会计准则的相关规定。

4、会计师意见

我们对公司账面研发项目执行了下述核查程序：

- 1) 了解公司与研发活动相关的内部控制，评价其设计的合理性，测试运行的有效性。
- 2) 检查研发项目的基本资料，包括可行性研究报告、立项审批、测试报告等研发过程控制资料；判断公司研发项目各阶段划分是否符合准则要求，对应会计处理是否正确。

3) 对各项目各研发阶段发生的研发费用结构进行分析, 并结合项目控制资料分析其费用结构的合理性。同时对研发费用在不同研发项目之间的归集和分配方法的合理、合规性进行判断。

4) 检查公司对研发项目符合研发支出资本化条件的分析说明材料, 评价说明材料是否与研发项目基本资料中所涉及的相关内容是否一致。

5) 获取开发支出明细表, 抽查各月支出中的职工薪酬、折旧等主要费用, 并与相关科目核对是否相符, 核实主要费用的准确性。

通过执行上述核查程序, 我们认为, 公司研发项目研究阶段、开发阶段的划分及相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

中国·北京

二〇一八年六月二十二日

中国注册会计师:

(项目合伙人)

黄琼

中国注册会计师:

慕东钰
